江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届临事会第十一次会议,审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,该议案无需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下:

根据目前经济环境及公司经营的总体情况,结合公司2025年度资金使用计 划的需要,公司拟向银行等金融机构申请综合授信人民币 15 亿元额度,包括短 期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、并购贷款及项目贷款等形式, 上述综合授信期限为自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至下一 次审议相同事项的董事会召开之日止。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内, 并以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资 金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

为提高工作效率,授权公司财务总监或其指定的授权代理人在上述授信总额 度内办理额度申请事官,与银行签署相关合同及法律文件,并授权财务部办理相 关手续。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决,由财务总 监确定并执行。

特此公告。